

이 보고서는 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해 발간한 보고서입니다.

기술분석보고서

 YouTube 요약 영상 보러가기

아모텍(052710)

하드웨어/IT장비

요약

기업현황

시장동향

기술분석

재무분석

주요 변동사항 및 전망



작성기관

NICE평가정보(주)

작성자

지혜련 전문연구원

- 본 보고서는 「코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신방안」의 일환으로 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해, 한국거래소와 한국예탁결제원의 후원을 받아 한국IR협의회가 기술신용평가기관에 발주하여 작성한 것입니다.
- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미게재 상태일 수 있습니다.
- 카카오톡에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-2124-6822)으로 연락주시기 바랍니다.



한국IR협회

아모텍(052710)

검증된 세라믹 소재 부품 분야 전문기업, MLCC 사업 진출

기업정보(2021/03/31 기준)

대표자	김병규/정준환
설립일자	1994년 10월 20일
상장일자	2003년 08월 01일
기업규모	중견기업
업종분류	전자부품 제조업
주요제품	세라믹 칩, 안테나 부품, 모터 부품

시세정보(2021/08/06 기준)

현재가(원)	29,600
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	2,884
발행주식수	9,743,406
52주 최고가(원)	43,700
52주 최저가(원)	27,700
외국인지분율	4.01%
주요주주	김병규

■ 세라믹 소재 부품 분야 전문기업

아모텍(이하 동사)은 세라믹 소재 부품 분야 전문기업으로 1994년 설립 이후 전자기기 관련 사업을 해왔다. 1990년대 IT 성장에 따라 선제적으로 기술력 확보에 나서 소재·부품 국산화를 이루었으며, 최근에는 산업통상자원 부로부터 전기·전자 부문 소부장 으뜸기업에 선정되기도 하였다. 동사는 칩 바리스터, NFC 안테나, 무선충전 안테나, 감전보호소자 등 해당 분야에서 글로벌 기업으로 성장해왔으며, 미래 유망산업인 에너지, 환경 부문의 핵심 소재 부품 및 솔루션 개발을 위해 연구에 매진하고 있다.

■ 검증된 신소재 기술을 기반으로 한 사업 영역 확장

신소재 분야 산업 특성상 기술의 변화속도가 빨라 효율적 대응을 위해 꾸준한 연구개발이 필요하다. 동사는 신소재 분야를 연구개발 해왔으며, 여러 가지 국책과제를 수행하며 기술 역량을 키웠다. 이를 기반으로 IT 산업에서 자동차 전장 산업으로 사업을 빠르게 확장시켰다. 설립 초기 칩 바리스터를 주력 제품으로 성장한 뒤, 세계시장 점유율 1위를 기록하였으며, 이후 안테나 및 모터 산업에 진출하여 제품개발에 성공하는 등 유연하게 사업 영역을 넓혀왔다.

■ MLCC 사업 진출에 따른 외형 성장 기대

동사는 전자제품에 사용되는 핵심부품 중 하나인 적층세라믹콘덴서(MLCC)를 개발하였다. 전극 재료 차이에 따라 BME 계열(전장용)과 PME 계열(통신용)로 나뉜다. 동사는 기술력을 앞세운 프리미엄 제품 노선으로 시장에 빠르게 진입하고자 먼저 PME 분야에 진출하였다. 5세대(5G) 통신을 위해 사용되는 PME MLCC를 통해 통신 시장에 진입하고 사업을 안정시킨 뒤, 영역을 넓혀 궁극적으로 전장 시장에 진출하고자 한다.

요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

구분 년	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2018	2,534	(19.7)	113	4.5	71	2.8	3.7	1.8	100.5	730	20,260	24.6	0.9
2019	2,486	(1.9)	70	2.8	4	0.1	0.2	0.1	116.5	37	20,412	795.0	1.5
2020	2,239	(9.9)	(49)	(2.2)	(166)	(7.4)	(8.7)	(3.8)	137.6	(1,700)	18,815	N/A	2.1

기업경쟁력

세라믹 소재 부품 분야 전문기업

■ 세라믹 칩 분야 선두기업

- 칩 바리스터 세계 시장 점유율 1위 기록

■ 안테나 분야

- 삼성전자 스마트폰에 근거리 결제시스템용 NFC 채택

■ 모터 분야

- 기존 DC 모터보다 개선된 BLDC 모터 개발 성공

핵심경쟁력

■ 신소재 원천기술 보유

- 세라믹 소재 관련 원천기술 보유
- 자체 원재료 조성기술 보유

■ 신성장 동력 사업 실시

- MLCC 사업 진출
- PME MLCC를 통해 통신 시장 진입 발판 마련
- 추후 전장 시장 진입 계획

핵심기술 및 취급 품목

핵심기술

■ 설계기술

- 소형화 설계기술, 박막 패턴 설계기술, 회로 설계기술, 매칭 최적화 기술 등 보유

■ 공정기술

- 양산 노하우 보유, 열처리 컨트롤 기술, 정밀 제조공법 (인쇄, 단자형성 등)

주요 제품

세라믹 칩	안테나 부품	모터
		

ESG 현황

Environment

항목	현황
환경 정보 공개	田
환경 경영 조직 설치	田
환경 교육 수준	田
환경 성과 평가체계 구축	田
온실가스 배출	□
에너지, 용수 사용	□
신재생 에너지	□

田 : 양호 ■ : 미흡 □ : 확인불가

Social

항목	현황
인권보호 정책 보유	□
여성/기간제 근로자 근무	□
협력사 지원 프로그램	田
공정거래/반부패 프로그램	□
소비자 안전 관련 인증	□
정보보호 안전 관련 인증	□
사회공헌 프로그램	田

田 : 양호 ■ : 미흡 □ : 확인불가

Governance

항목	현황
주주의결권 행사 지원제도	田
중장기 배당정책 보유	田
이사회 내 사외이사 보유	田
대표·이사회 독립성	田
감사위원회 운영	田
감사 업무 교육 실시	田
지배구조 정보 공개	田

田 : 양호 ■ : 미흡 □ : 확인불가

➢ 당사는 동사의 홈페이지에 환경 관련 정보를 공개하고 내부환경관리 조직을 운영하고 있으며 정기적인 환경 교육 프로그램을 수행 중으로 대표이사 및 경영진이 ESG관심이 높아 적극 경영활동에 반영함
➢ 이사회 내 사외이사를 보유하고 있어 이사회 독립성을 확보하고 있으며, 감사위원회를 운영 중에 있음.

* 본 ESG현황은 나이스평가정보사가 분석대상 기업으로 입수한 정보를 요약 정리한 것으로, 분석 시점 및 기업의 참여도에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

I. 기업현황

세라믹 소재 부품 분야 전문기업

설립 이래 전자기기 관련 사업을 실시해 왔으며, IT 분야 기술력 확보로 소재·부품 국산화를 이루었다. 칩 바리스터, NFC 안테나, 감전보호소자 등의 글로벌 기업으로써 검증된 신소재 기술을 바탕으로 유연하게 사업 영역을 확장하고 있다.

■ 개요

1994년 10월 (주)아모스, 1995년 8월 (주)아모트론, 1998년 12월 (주)아맥스를 각각 설립하여 운영해오다 1999년 11월에 3사를 합병하였다. 같은 해 12월 (주)아모텍으로 상호를 변경하였으며, 2003년 8월 코스닥시장에 상장하였다.

1998년 3월 및 7월에는 인천 남동구에 신소재 연구소, 모터연구소를 설립하여 연구개발 분야를 강화하였고, 해외 고객사와의 접근성을 높이기 위해 중국(산둥, 청도, 상해), 베트남 및 북미에 각각 현지 생산, 판매 법인을 설립하였다. 한편, 동사의 사업 부문별 주요 현황으로 세라믹 칩, 안테나 부품, 모터 분야가 있다.

그림 1. 사업 현황



*출처: 회사소개서(2020), NICE평가정보(주) 재구성

■ 주요주주 및 계열회사 현황

동사의 최대주주는 김병규 대표이사로 16.54%의 지분을 보유하고 있으며, 미래에셋자산운용(주) 11.45%, 국민연금공단이 7.57%, 엘트웰텍(주) 10.68%의 지분을 보유하고 있다. 동사의 계열사로 (주)아모그린텍, (주)아모라이프사이언스, (주)아모센스 등이 있으며, 자회사(100% 출자)로 산동아모텍전자유한공사(중국), 청도아모텍유한공사(중국), 아모(상해)무역유한공사(주), 아모비나유한공사(베트남), (주)아모에스넷(국내) 등을 보유하고 있다.

표 1. 주요주주 및 계열회사 현황

주요주주	지분율(%)	계열회사	지분율(%)
김병규	16.54	(주)아모그린텍	17.58
미래에셋자산운용(주)	11.45	(주)아모라이프사이언스	20.98
국민연금공단	7.57	(주)아모센스	23.86
엘트웰텍(주)	10.68	MSTATOR	32.00

*출처: 2021년 7월 공시 자료 및 분기보고서(2021.3월), NICE평가정보(주) 재구성

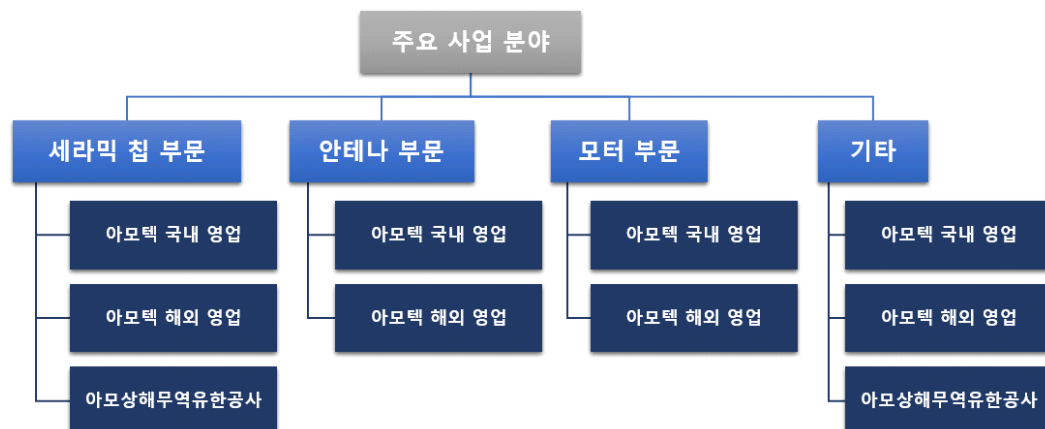
■ 대표이사 정보

김병규 각자 대표이사는 1998년 5월, 정준환 각자 대표이사는 2010년 4월에 취임하였으며, 현재까지 동사를 경영해오고 있다. 김병규 대표이사는 서울대학교 대학원 금속공학 박사 출신으로 동사 설립부터 경영에 참여해왔으며, (사)코스닥협회 회장, 한국과학기술기획평가원 전기/전자부문 심사평가위원 등을 역임하였다. 정준환 대표이사는 KAIST 재료공학 박사 출신으로 대우조선, 동양화학(주), 동양산전(주) 등에 근무하였다.

■ 사업 분야 및 주요 제품

등기임원은 사내이사 3명과 사외이사 1명 그리고 감사 1명으로 구성되어 있으며, 등기임원을 제외한 총 793명의 직원이 근무하고 있다. 주요 사업 분야는 세라믹 칩, 안테나 부품, 모터가 있으며, 사업 분야마다 국내외 영업 전담팀을 보유하고 있다.

그림 2. 주요 사업 분야



*출처: 분기보고서(2021.3월), NICE평가정보(주) 재구성

세라믹 칩 부품의 대표적인 제품으로 칩 바리스터, 감전보호소자 및 EMI 필터가 있으며, 안테나 부품으로 NFC, GPS, GNSS 등이 있다. 또한, BLDC 모터로 In Car Sensor Motor, LCF, EWP, WDD 등이 있다. 2021년 5월 분기보고서 기준(1분기), 분야별 매출 비중은 세라믹 칩 부품 15.54%, 안테나 부품 59.1%, 모터 20.98%, 기타 4.38%이다.

그림 3. 주요 제품

세라믹 칩	안테나	모터
		
다양한 디지털 기기 및 자동차 장치 내에서 정전기(ESD)와 전자파(EMI)를 막아주는 부품으로 IC 칩, 회로, 인터페이스 단자 등을 보호함.	자동차, 휴대폰, 노트북 등의 기기에서 무선 통신을 가능하게 하는 부품으로 Bluetooth, GPS, NFC, MST 등에 사용되고 있음.	BLDC 모터는 기존 DC 모터와 달리 Brush 장치를 전자회로로 대체한 모터이며, 고효율, 장수명, 저소음의 특징을 가지는 차세대 Smart Motor.

*출처: 동사 홈페이지(2021), NICE평가정보(주) 재구성

■ 연구개발 활동

동사는 신소재 제2연구소, 신소재 연구소, 모터연구소를 각각 운영하고 있다. 신소재 제2연구소에서는 유전체 세라믹 소재기술, 제조공정기술, 안테나 부품 설계기술의 확보를 목표로 기술개발하고 있다. 또한, 신소재 연구소는 차세대 신소재 및 부품 개발을 하고 있으며, 모터연구소는 BLDC 모터 Basic Design 및 주요 설계 Parameter Simulation 등을 연구개발하고 있다. 특히, 연구개발 투자 효율성을 높이고 연구 생산성 향상에 기여 하고자 정부 부처가 주관하는 국가 과제 및 사업에 참여하고 있으며, 다양한 연구개발사업을 수행함으로써 기술(제품)개발 시스템을 강화하고 개발품의 신뢰성 향상에 힘쓰고 있다.

표 2. 국가 R&D 과제 및 사업 실적 최신 현황

사업기간	과제명	기대효과
2018.11 ~ 2022.12	General Aviation급 항공기 전기추진시스템용 65kW급 추진모터와 시동발전기 개발	<ul style="list-style-type: none"> 항공기용 추진 모터/발전기의 출력/비출력 정량 목표 달성 인버터와 정류기의 무게 및 효율 정량 목표 달성
2018.10 ~ 2021.09	자동차 구조용 부품 제작을 위한 무연신 열가소성 나노복합 필름 함침 100 μ m 이하 급 연속 탄소섬유 강화 테이프 및 인서트 프리폼 개발	<ul style="list-style-type: none"> 열가소성 나노 복합 필름 및 CFRTP 테이프 대량 생산 공정 구축
2017.07 ~ 2020.12	나노입자/열가소성 폴리머 복합 수지 적용 섬유 광폭 스프레딩 방식 고품질 섬유강화 열가소성 나노 복합재료 개발 및 이를 이용한 전기자동차용 배터리 팩 보호용 언더바디 쉴드 개발	<ul style="list-style-type: none"> 자동차 소재 부품 및 나노복합재 산업계 기술 및 경제적 큰 파급효과 기대
2017.07 ~ 2020.06	B2C 고객에게 저전력/저비용 기반의 SIGFOX Tacker를 통한 상황인지 기반의 위치기반 서비스 개발	<ul style="list-style-type: none"> IoT망을 이용하여 글로벌 IoT 망을 하나의 Band로 묶고 있는 SIGFOX망을 이용하여 저전력, 저비용으로 서비스

*출처: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS), NICE평가정보(주) 재구성



한국산업기술진흥협회에 등록된 기술연구소(총 3곳)를 현재까지 운영하고 있으며, 연구개발기획, 부품개선, 장치기술개발, 구조해석, 설계검증 등의 업무를 수행하고 있다. 핵심기술에 대한 기술적 권리성과 법적 안정성을 위해 동사 명의로 확보한 지식재산권은 작성일 기준 국내 특허 등록 445건, 디자인 등록 7건 및 상표 등록 53건 등(그 외 해외 특허/출원 다수)이 있다.

표 3. 주요 특허 실적

구분	특허명	등록번호	등록일
특허	무선 충전 송신모듈	KR 10-2249811	2021.05.03
특허	콤보 안테나 모듈 및 이의 제조 방법	KR 10-2239249	2021.04.06
특허	콤보 안테나 모듈 및 이의 제조 방법	KR 10-2239236	2021.04.06
특허	콤보 안테나 모듈 및 이의 제조 방법	KR 10-2239231	2021.04.06
특허	콤보 안테나 모듈	KR 10-2200083	2021.01.04
특허	콤보 안테나 모듈	KR 10-2178575	2020.11.09
특허	회로 보호 소자	KR 10-2175234	2020.11.02
특허	지능형 반도체를 포함한 피부 부착용 체온 센서모듈	KR 10-2171308	2020.10.22
특허	차량용 공통 모드 필터	KR 10-2154237	2020.09.03
특허	패치 안테나	KR 10-2154226	2020.09.03
특허	콤보 안테나 모듈	KR 10-2137633	2020.07.20
특허	복합형 감전방지소자 및 이를 구비한 휴대용 전자장치	KR 10-2136150	2020.07.15
특허	안테나 모듈	KR 10-2121795	2020.06.05
특허	후면 커버 및 이를 구비하는 휴대 단말	KR 10-2119533	2020.06.01
특허	감전보호소자 및 이를 구비하는 휴대용 전자장치	KR 10-2119512	2020.06.01
특허	소형 구동 모터, 이를 이용한 에어 벤트 시스템용 액추에이터 및 그의 제조방법	KR 10-2109728	2020.05.06
특허	복합기능소자 및 이를 구비한 전자장치	KR 10-2108947	2020.05.04
특허	감전보호소자	KR 10-2108900	2020.05.04
특허	콤보 안테나 모듈	KR 10-2099310	2020.04.03
특허	안테나 성능 시험장치	KR 10-2088036	2020.03.05

*출처: 특허정보넷(KIPRIS), NICE평가정보(주) 재구성

표. 시장 동향

전자정보통신 분야의 핵심부품 소재: 세라믹 소재

동사의 사업 분야는 크게 세라믹 칩, 안테나 부품, 모터 부품으로 분류되며, 해당 부품의 핵심 소재로 사용되고 있는 세라믹 소재에 대한 원천기술을 확보하고 있다. 주요 제품으로 칩 바리스터 등이 있으며, 신성장 동력 제품으로 MLCC가 있다.

■ 광·전자 세라믹 소재 산업

광·전자 세라믹은 세라믹의 전기·전자적 성질을 이용하여 전자·정보통신 분야에 활용되는 주요 핵심 소재이다. 이는 산화물 반도체, 투명 디스플레이, 초소형 세라믹 콘덴서, LED 조명, 로봇용 첨단센서, 고감도 기상장비 등에 활용되고 있다. 최종 제품의 특성을 향상시키기 위해 소재 개발에 대한 노력이 필요하며, 다양한 요구 성능 조건을 충족하기 위한 융·복합 기능화가 트렌드로 자리 잡고 있다.

표 4. 광·전자 세라믹 주요 활용 분야

활용 분야		주요 내용
산화물 반도체		<ul style="list-style-type: none"> Flexible IT 제품 등 첨단제품의 핵심 고속 정보처리 기능 소재
투명 디스플레이		<ul style="list-style-type: none"> 초슬림 디자인·편리성 제공 높은 투명성·강도 및 회로 노이즈 제거
초소형 세라믹 콘덴서		<ul style="list-style-type: none"> 첨단제품의 초슬림화 구현 전류의 안정성 및 회로 노이즈 제거
LED 조명		<ul style="list-style-type: none"> 초절전·친환경 조명 실현 환경 친화형, 에너지 절감 소재
로봇용 첨단센서		<ul style="list-style-type: none"> 극미세·초정밀 센서 구현 내열성, 고강도·내마모성 우수
고감도 기상장비		<ul style="list-style-type: none"> 고감도·고정밀 기상관측 실현 관측 신뢰성 및 장비 내구성 향상

*출처: 중소기업 기술개발 전략로드맵(2020), NICE평가정보(주) 재구성

광·전자 세라믹 후방산업은 휴대폰, 디스플레이, 반도체 산업 분야 국내 선두기업으로 인해 지속 성장하고 있으며, 수요산업의 빠른 발전에 대응하기 위해 광·전자소재에 대한 기술개발이 필요하다. 한편, 전방산업은 광전자 세라믹 제조 관련 장비가 반도체, 디스플레이 산업 관련 설비와 유사한 특성이 있어 국내의 경우 세계적인 기술 경쟁력을 단시간에 확보할 수 있다.

표 5. 광·전자 세라믹의 연관 산업 구조

후방산업	광·전자 세라믹 산업	전방산업
전자/통신 부품 및 디스플레이용 원료 및 소재	필터, 액츄에이터, 센서, 진동자, 투명전극재, 서미스터, MLCC, 칩저항·인덕터·캐패시터, 기판	평판 TV 등 디스플레이, 스마트폰 등 이동 통신기기, 유비쿼터스 산업

*출처: 중소기업 기술개발 전략로드맵(2020), NICE평가정보(주) 재구성

광·전자 세라믹 시장의 확대로 해당 소재에 대한 수요가 지속적인 증가세를 보일 전망이다. 중소기업 기술로드맵(2020)에 따르면, 세계 광·전자 세라믹 시장규모는 2016년 441억 달러에서 2021년 540억 달러가 될 것으로 전망하고 있다. 세계시장의 70% 이상을 미국과 일본이 차지하고 있으며, 이는 앞으로도 계속될 전망이다.

표 6. 세계 광·전자 세라믹 시장규모 및 전망

구분	시장규모(억 달러)	성장률(YoY)	시장규모 및 전망																					
2016년	441	-	<p>■ 세계 시장규모(억 달러) ◆ 성장률(%)</p> <table><thead><tr><th>연도</th><th>시장규모(억 달러)</th><th>성장률(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016년</td><td>441</td><td>-</td></tr><tr><td>2017년</td><td>458</td><td>3.85%</td></tr><tr><td>2018년</td><td>476</td><td>3.93%</td></tr><tr><td>2019년</td><td>497</td><td>4.41%</td></tr><tr><td>2020년</td><td>518</td><td>4.23%</td></tr><tr><td>2021년</td><td>540</td><td>4.25%</td></tr></tbody></table>	연도	시장규모(억 달러)	성장률(%)	2016년	441	-	2017년	458	3.85%	2018년	476	3.93%	2019년	497	4.41%	2020년	518	4.23%	2021년	540	4.25%
연도	시장규모(억 달러)	성장률(%)																						
2016년	441	-																						
2017년	458	3.85%																						
2018년	476	3.93%																						
2019년	497	4.41%																						
2020년	518	4.23%																						
2021년	540	4.25%																						
2017년	458	3.85(%)																						
2018년	476	3.93(%)																						
2019년	497	4.41(%)																						
2020년	518	4.23(%)																						
2021년	540	4.25(%)																						

*출처: 중소기업 기술개발 전략로드맵(2020), NICE평가정보(주) 재구성

또한, 국내 광·전자 세라믹 시장규모는 2016년 2조 4,241억 원에서 2021년 2조 9,354억 원이 될 것으로 전망하고 있다. 2015년 이후 매년 4% 내외로 성장을 지속해왔다.

표 7. 국내 광·전자 세라믹 시장규모 및 전망

구분	시장규모(억 원)	성장률(YoY)	시장규모 및 전망																					
2016년	24,241	-	<p>■ 국내 시장규모(억 원) ◆ 성장률(%)</p> <table><thead><tr><th>연도</th><th>시장규모(억 원)</th><th>성장률(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016년</td><td>24,241</td><td>-</td></tr><tr><td>2017년</td><td>25,200</td><td>3.96%</td></tr><tr><td>2018년</td><td>26,198</td><td>3.96%</td></tr><tr><td>2019년</td><td>27,325</td><td>4.30%</td></tr><tr><td>2020년</td><td>28,499</td><td>4.30%</td></tr><tr><td>2021년</td><td>29,354</td><td>3.00%</td></tr></tbody></table>	연도	시장규모(억 원)	성장률(%)	2016년	24,241	-	2017년	25,200	3.96%	2018년	26,198	3.96%	2019년	27,325	4.30%	2020년	28,499	4.30%	2021년	29,354	3.00%
연도	시장규모(억 원)	성장률(%)																						
2016년	24,241	-																						
2017년	25,200	3.96%																						
2018년	26,198	3.96%																						
2019년	27,325	4.30%																						
2020년	28,499	4.30%																						
2021년	29,354	3.00%																						
2017년	25,200	3.96(%)																						
2018년	26,198	3.96(%)																						
2019년	27,325	4.30(%)																						
2020년	28,499	4.30(%)																						
2021년	29,354	3.00(%)																						

*출처: 중소기업 기술개발 전략로드맵(2020), NICE평가정보(주) 재구성

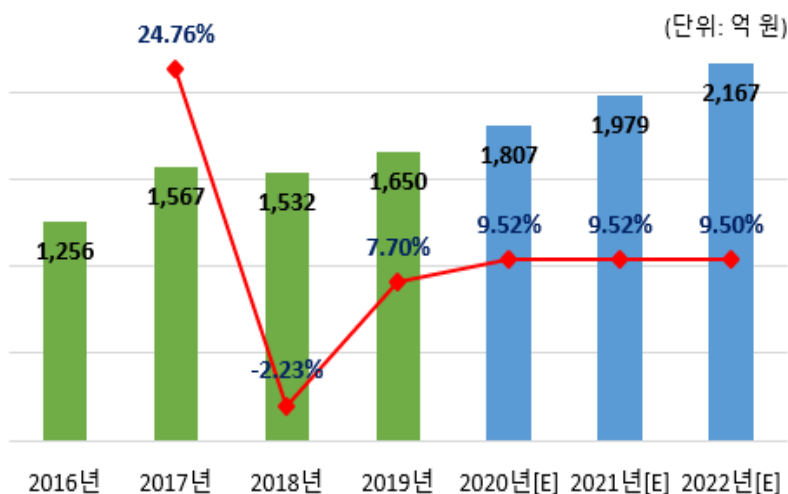
■ 세라믹 칩 산업

1. 바리스터 분야

바리스터(C26292203)는 전자파, 정전기, 과전압 등으로부터 IC 회로 손상을 방지하기 위해 휴대용 디바이스에 필수적으로 적용되고 있다. 특히 휴대폰은 단말기 소형화, 고기능화, 고화질화에 따라 제품 수요가 큰 폭으로 증가하면서 바리스터의 최대 수요처가 되었다.

통계청 광업·제조업(품목편) 조사(2021)에 따르면, 국내 바리스터 출하금액은 2016년 1,256억 원에서 2019년 1,650억 원으로 연평균 9.52% 증가하였으며, 시장 환경, 업황 등을 감안할 시, 2022년에는 2,167억 원의 시장을 형성할 것으로 전망된다. 주요 기업으로 동사를 비롯하여 하이엘, 모다이노칩, 래트론 등이 있다.

그림 4. 국내 바리스터 시장규모 및 전망



*출처: 통계청 광업·제조업(품목편)(2021), NICE평가정보(주) 재구성

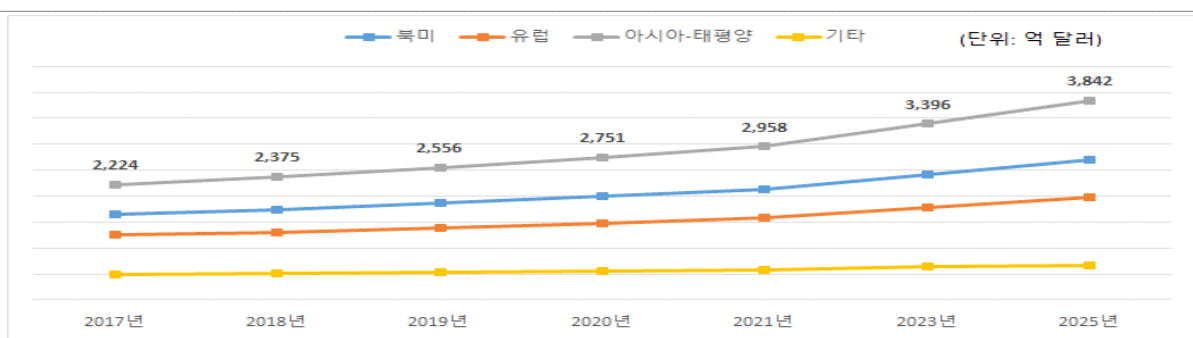
2. EMI 필터 분야

EMI(Electromagnetic Interference, 전자파 간섭)는 전자기기가 발생시킨 전자파로 인해 다른 전자기기의 정상적인 작동을 방해하는 상태를 말한다. EMI 차폐는 테이프나 합판, 전도성 코팅 및 페인트, 금속, EMI/EMC 필터, 전도성 폴리머와 같은 재료를 사용하여 전자파 간섭을 줄이는 기술로 전자기기의 성능 저하 없이 전자파를 차단할 수 있다.

KIST 기술정책연구소 글로벌 시장 동향 보고서(2020)에 따르면, 세계 EMI 차폐시장은 2017년 5,610억 달러에서 2019년 6,355억 달러를 형성하였으며, 2020년부터 2025년까지 6.3%의 연평균 성장률을 나타내어 9,211억 달러를 형성할 것으로 전망된다. 이중 아시아-태평양 지역은 2019년 전체 시장의 40%를 차지하였으며, 2020년부터 2025년까지 6.9%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망된다.

표 8. 세계 EMI 차폐 시장규모(억달러) 및 전망

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2023년	2025년	연평균 성장률
북미	1,648	1,746	1,866	1,994	2,129	2,410	2,708	6.3(%)
유럽	1,246	1,307	1,393	1,484	1,580	1,778	1,989	6.0(%)
아시아-태평양	2,224	2,375	2,556	2,751	2,958	3,396	3,842	6.9(%)
기타	496	516	540	564	589	637	671	3.5(%)
전체	5,610	5,944	6,355	6,793	7,255	8,221	9,211	6.3(%)



*출처: KIST 기술정책연구소 글로벌 시장 동향(2020), NICE평가정보(주) 재구성

3. 콘덴서(MLCC) 분야

콘덴서는 IT산업의 쌀로 불리는 부품으로 전자산업과 함께 성장하는 특징을 지니고 있다. 전 해 콘덴서는 동남아시아 및 중국의 저가제품과 글로벌 완전경쟁체제를 나타내고 있다. 최근에는 고기능, 다기능화된 디지털 세트의 신규 출현과 함께 고집적 회로가 사용되는 스마트기기에 적합한 특징을 지닌 적층세라믹콘덴서(MLCC) 시장을 중심으로 성장세를 나타내고 있다.

NICE 산업분석보고서(콘덴서 산업 부문, 2021)에 따르면, 2019년 국내 콘덴서 합산 매출액은 자동차의 전장화 및 자율주행화 추세에도 미국과 중국의 무역분쟁 여파 등으로 수요산업인 스마트폰 및 PC, TV 수요가 위축된 가운데 선두권 업체들의 설비증설에 따른 공급과잉 현상으로 MLCC 가격도 하락하면서 전년 대비 13.45% 감소한 5,246억 원을 기록하며 부진한 모습을 보였다.

표 9. 국내 콘덴서 시장규모 및 전망

구분	시장규모(억 원)	성장률(YoY)	시장규모 및 전망
2016년	4,866	-	
2017년	5,311	9.15(%)	
2018년	6,061	14.12(%)	
2019년	5,246	-13.45(%)	

*출처: 중소기업 기술개발 전략로드맵(2020), NICE평가정보(주) 재구성



2020년 국내 콘덴서 산업은 COVID-19 영향으로 전반적인 스마트폰 출하량 감소 및 자동차 업계의 생산 차질에도 불구하고 비대면 서비스 관련 노트북, 서버 등 IT용 MLCC의 수요 호조와 하반기 갤럭시노트, Z폴드 2 및 아이폰12 등 신규 5세대 이동통신(5G)폰 출시 등에 힘입어 전년대비 회복세를 보인 것으로 추정된다.

2021년 이후에는 세계 경제 회복세 및 COVID-19 안정화가 기대되는 가운데 5G 스마트폰 출시 확대에 따른 초소형·고용량·고성능 콘덴서의 수요 증가와 AI, IoT, 클라우드 서버 등 관련 인프라 구축으로 성장세를 이어갈 것으로 전망된다. 또한, 자동차의 자율주행 등 운전자 편의성 향상을 위한 전자장비 채용 확산과 더불어 전기차 비중 확대 등으로 전장용 MLCC에 대한 수요도 증가하면서 시장 성장을 이끌 것으로 전망된다.

Ⅲ. 기술분석

세라믹 소재 부품 분야 강자

동사는 칩 바리스터 분야 세계시장 점유율 1위를 기록하였으며, 이후, 안테나, 모터 산업에 진출하여 제품개발에 성공하는 등 유연하게 사업 영역을 넓혀왔다.

■ 세라믹 칩

세라믹 칩 부품은 휴대용 전자기기의 핵심부품으로서 핸드폰 등 전방산업의 경기에 크게 영향을 받고 있으며, 지속적인 성장에 힘입어 꾸준히 성장세를 나타내고 있다. 스마트폰, 태블릿 PC 등 휴대용 전자기기의 고기능화 및 고집적화로 보호해야 하는 IC칩의 종류가 많아짐에 따라 채용 비율과 적용 수량이 점점 늘고 있다.

동사는 주로 핸드폰 관련 국내외 주요 업체들에 세라믹 칩을 납품하고 있어 핸드폰 시장의 경기변동에 밀접한 영향을 받고 있다. 이에 디스플레이, 가전 등 다양한 분야로의 확대를 통해 경기변동에 따른 영향을 최소화하고자 노력하고 있다.

표 10. 세라믹 칩 주요 제품

구분	내용	관련 사진
칩 바리스터	<p>(기능)</p> <p>정전기, Surge 보호용 단품 바리스타로 시장에서 가장 폭넓게 사용되고 있는 제품.</p> <p>(핵심경쟁력)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 다층 적층 형태의 구조 • Diode보다 빠른 외부 과도 전압 응답속도 • 다중 Surge에 대한 높은 신뢰도 • Diode와 다른 +, -의 양방향 특성 • 낮은 누설 전류값 및 인덕턴스값 • 다양한 정전용량별 제품 보유 • ESD(Electrostatic Discharge)에 대한 높은 신뢰성 	
감전 보호소자	<p>(기능)</p> <p>메탈케이스를 가진 전자기기에서 충전 시, 감전 위험을 방지해주는 소자, 외부 메탈케이스와 연결되는 내부 회로부에 배치되어 감전전류를 차단하는 기능을 수행함.</p> <p>(핵심경쟁력)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 감전전류의 차단과 정전기 통과 기능을 동시 수행 • 안테나 회로에 사용 가능한 다양한 정전용량 보유 • ESD 및 감전 전압에 대한 내성 보유 	



MLCC (High Q MLCC)	<p>(기능) 통신용 RF 파워 앰프의 매칭 및 DC Blocking으로 사용되며, 저손실의 특성이 요구됨.</p> <p>(핵심경쟁력)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 다양한 Size 대응 • 높은 DC Working Voltage • 자기 공진 주파수의 고주파 설계 • Precious Metal 내재 • RoHS 준수 	
EMI Filter (EMI ESD Filter R-C Type)	<p>(기능) R-C Type의 EMI/ESD 복합 기능 필터로 디지털 회로에 배치되어 EMI 노이즈 저감과 동시에 정전기 및 서지로부터 회로를 보호하는 기능을 수행함.</p> <p>(핵심경쟁력)</p> <ul style="list-style-type: none"> • R-C Type의 EMI+ESD(또는 Surge)의 복합 기능 수행 • 4채널 Array 형태로 공간 절약 • 다양한 저항 및 정전용량 보유 	


*출처: 동사 홈페이지(2021), NICE평가정보(주) 재구성

■ 안테나 부품

안테나 부품은 전자기기의 무선 및 모바일화 핵심부품으로서 차세대 무선통신을 겨냥한 신소재 부품이다. 핸드폰이 점차 다기능화, 고집적화됨에 따라 Bluetooth, GPS 등의 기능이 기본적으로 탑재되고 있으며, 여러 분야에 걸쳐 모바일 및 Wireless화 되며 연관 시장은 꾸준히 성장해왔다.

동사는 다양한 안테나 부품 군 중에서도 핸드폰 및 차량용 Bluetooth, GPS 부품을 주로 생산하고 있다. 다년간 유전체 세라믹 소재에 관련하여 연구 개발해 왔으며 국내외로 특허 출원 및 등록하고 있다. 이를 통해 개발한 파우더를 적용함으로써 안테나 부품의 제조 원가를 절감하였다. 또한, 최신 결제 시스템인 NFC(Near Field Communication)와 MST(Magnetic Secure Transmission)를 채택하여 NFC 및 MST용 안테나 부품을 공급하고 있다. 그 외 NFC/MST/WPC 동시 적용, NFC/MST/무선 충전 모듈 등 제품 다양화에 힘쓰고 있다.

표 11. 안테나 부품 주요 제품

구분	내용	관련 사진
NFC	<p>(기능) RFID(Radio Frequency Identification) 기술 중 13.56MHz 대역을 이용한 스마트폰 기반 무선통신 기술</p> <p>(핵심경쟁력)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 자성재료 설계, 안테나 설계 및 매칭 최적화 기술 • 인증용 장비 보유 및 인증 지원(EMV, NFC Forum 등) 	



Passive GNSS	(기능) 위치 정보 파악을 위해 GNSS 위성 신호를 수신하는 안테나 (핵심경쟁력) <ul style="list-style-type: none"> • Low AR(Axial ratio) • GNSS L1, GNSS L2, GNSS L5 and RTK Inmarsat • Good isolation in stacked patch 	
Cellular (4G)	(기능) 4G(LTE) 신호를 송/수신하는 안테나 (핵심경쟁력) <ul style="list-style-type: none"> • High efficiency in a small size • SMD • Low price • Custom design available 	
Bluetooth	(기능) 휴대기간 블루투스 통신을 위한 안테나 (핵심경쟁력) <ul style="list-style-type: none"> • Compact size • SMD • Custom design available 	


*출처: 동사 홈페이지(2021), NICE평가정보(주) 재구성

■ BLDC 모터

BLDC 모터는 기존 DC 모터와 다르게 브러쉬와 정류자가 없어 브러쉬 마모에 의한 미세먼지가 발생하지 않는다. 또한, 고효율, 고속운전, 장수명, 저소음, 속도제어의 용이성 등에 효과를 가지고 있어 냉장고, 세탁기와 같은 대형가전부터 믹서기 등의 소형가전 그리고 하이브리드 자동차, 전기자동차, 가솔린/디젤 자동차까지 다양하게 사용되고 있다.

동사 제품은 경량화, 슬림화, 속도제어의 용이성 등에서 높은 효과를 가지며, 다품종 소량 생산에 유리한 강점을 가진다. 자동차 분야로 In Car Sensor 모터, 하이브리드 자동차용 BCF(Battery Cooling Fan) 모터, 전장용 Head Light Cooling Fan 모터를 생산하고 있으며, 가전 분야로 세탁기용 초박형 Intelligent BLDC 모터(WDD 모터)를 생산하고 있다.

표 12. BLDC 모터 주요 제품

구분	내용	관련 사진
In Car Sensor	(기능) 동사가 보유한 특허에 기반을 둔 온도 및 습도 조절용 모터 (핵심경쟁력) <ul style="list-style-type: none"> • 하우징 내부의 모터와 모터 드라이브 회로의 표준화 • 고객 시스템의 결합 부위 설계만으로 사용 가능 • 저소음, 낮은 진동 실현, 정확 신속한 온도 및 습도 제공 • 8~16V의 넓은 범위(직류전압)에서 동일한 성능 발휘 	



<p>BCF</p>	<p>(기능) 차량용 배터리 폭발 및 출력성능저하와 같은 상황의 원인이 될 수 있는 발열을 방지하는 역할을 담당함. 미래 배터리 시스템의 핵심부품으로 각광받고 있음.</p> <p>(핵심경쟁력)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PWM Command 사용으로 모터의 정확한 RPM 제어가 가능 • BMC Molding 및 Ball Bearing 사용으로 장수명 실현 • DC 모터 대비 우월한 내구성 보유 • 저소음 및 저진동 • 강한 EMC 내성을 갖춘 모터 	
<p>WDD</p>	<p>(기능) 직결식 BLDC 모터는 독자적인 특허 구조로 기존의 외전형 또는 내전형 BLDC 모터에 비해 크기와 무게가 적으면서 높은 출력을 낼 수 있는 고출력 밀도의 고효율 모터</p> <p>(핵심경쟁력)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 더블로터 구조의 고 출력밀도 구현으로 저소비전력 실현 • 방수 구조 • 고속 운전에서도 낮은 소음 유지 • 전자동 세탁기를 위한 기어 클러치 장착 구조 • 고객의 시스템과 매칭을 위한 신속한 기술 서비스 	

*출처: 동사 홈페이지(2021), NICE평가정보(주) 재구성

■ SWOT 분석

그림 5. SWOT 분석



*출처: NICE평가정보(주)

▶▶ (Strong Point) 세라믹 소재 부품 분야 강자, MLCC 사업 진출에 따른 외형 성장 기대

동사는 1994년 창립 이래 세라믹 소재를 바탕으로 칩 바리스터, NFC 안테나, 감전보호소자 등 부품 분야의 글로벌 기업으로 성장해왔다. 유전체 세라믹 소재기술 확보 등을 목표로 다양한 국책과제를 수행하면서 기술개발 역량을 키워왔으며, 기술 확보를 통해 소재·부품 국산화를 실현하였다. 최근에는 사업 다각화 목적으로 MLCC 사업에 진출하며 칩 소형화 및 안정성 개선의 성과를 이루었으며, MLCC 제품 양산을 준비하고 있어 매출 증대가 기대되고 있다.

▶▶ (Weakness Point) 매출 실적 악화 및 투자 감행에 따른 재무 부진

스마트폰용 부품 시장의 경쟁 구조가 치열해지면서 실적에 직격타를 받았다. 이후에도 막대한 투자를 감행한 결과 운영 자금의 부족으로 시중은행 등에 차입했기 때문이다. 이에 따라 2021년 4월 동사는 코스닥시장 우량기업에서 중견기업으로 변동되었으며, 재무 부진으로 동사에 의존도가 높은 그룹 계열사들도 적자 전환하였다. 다만, MLCC 개발 완료를 통한 신제품 출시 효과 및 전장 부품 매출 정상화로 올해 3분기부터 매출 반등 가능성이 제기됨에 따라 수익성 개선 및 영업 흑자 전환이 기대된다.

▶▶ (Opportunity Point) 세라믹 산업 핵심산업으로 급부상

중소기업 기술로드맵(2021)에 따르면, 4차 산업혁명 시대에 따른 첨단세라믹의 중요성 확대로 세라믹 패키지 산업이 다양한 파급효과를 일으키며 핵심산업으로 급부상하고 있다. 이동 통신기기(휴대폰 등), IT 기기 산업의 지속적인 발전과 시장 안정성을 극대화 시키는데 필요한 부품 소재의 수요 증가로 핵심원료의 자립화가 필요한 상태이다.

▶▶ (Threat Point) 첨단세라믹 산업의 높은 진입장벽

기술집약적인 첨단세라믹 소재 부품 산업은 기술개발, 설비투자, 국내외 영업망 확보 등의 측면에서 신규업체들에 대한 진입장벽이 높은 편이다. 미국, 일본 등 해외 소재·부품 선진국들은 기존 시장의 유지를 위해 축적된 기술 및 노하우를 바탕으로 고기능성, 고부가가치 제품개발에 치중하면서 시장지배력을 높이고 있어 상위 기업 간의 독과점 형태가 강한 구조이다.

IV. 재무분석

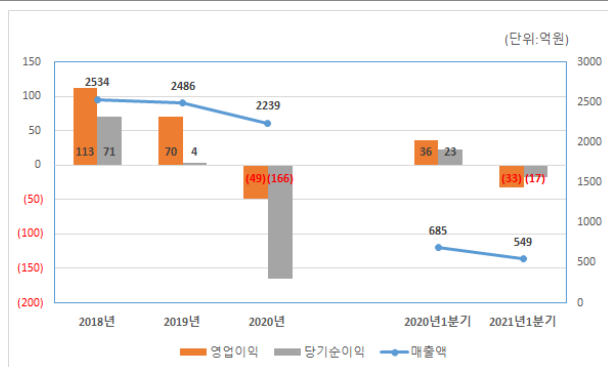
신소재를 바탕으로 한 종합 소재부품 전문기업

동사는 경기침체 및 전방 스마트폰 판매 감소 등에 따른 안테나 부품의 수요 부진으로 2020년 실적이 전년대비 감소하면서 수익성이 하락하였고 2021년 1분기 또한 매출액 감소한 상태로 손실을 나타내고 있다. 다만, 2021년 이후에는 5G 스마트폰 출시 확대 등에 따라 콘텐츠 수요 증가가 기대되며, 최근 전류 흐름을 안정적으로 제어하는 소자를 개발하는 등 신제품 출시를 통한 실적 회복이 전망된다.

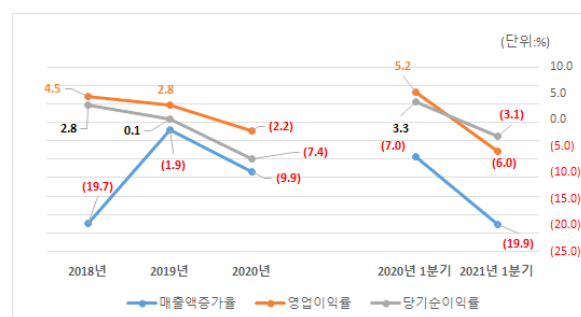
■ 휴대폰 시장의 경기침체 속 매출 감소

2020년 코로나 영향 등 전방산업인 휴대폰 시장의 경기침체에 따라 스마트폰 물량이 감소하였고, 이에 따른 모바일 관련 부품들의 실적 악화로 연결기준 9.9% 감소한 2,239억 원의 매출을 시현하였다. 이 중 Bluetooth, GPS, NFC 등 무선통신을 위한 안테나 부문 매출이 약 1,300억 원(매출 비중 약 58%), 정전기 및 전자파를 방지하는 세라믹 칩 부품 부문 매출이 약 462억 원(매출 비중 약 21%)을 기록하였다.

그림 6. 동사 연간 및 1분기 요약 포괄손익계산서 분석



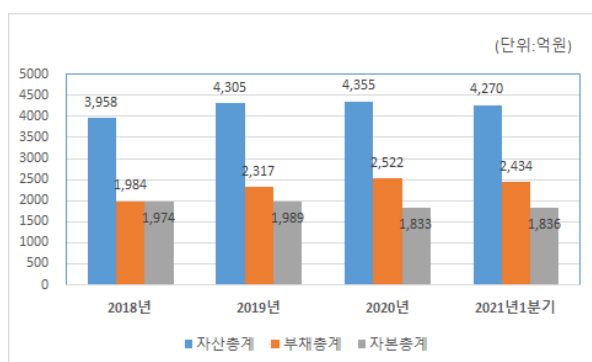
매출액/영업이익/당기순이익 추이



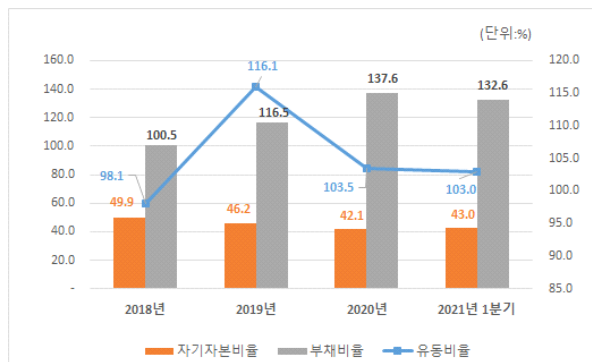
증가율/이익률 추이

*출처: 동사 사업보고서(2020), 분기보고서(2021)

그림 7. 동사 연간 및 1분기 요약 재무상태표 분석



부채총계/자본총계/자산총계 추이



유동비율/자기자본비율/부채비율 추이

*출처: 동사 사업보고서(2020), 분기보고서(2021)

■ 실적 감소 및 수익성 적자 전환

동사는 IT 및 모바일 전방사업 업황 부진, 스마트폰용 부품 시장 경쟁 확대, 5G 투자 지연 등의 영향으로 최근 3년간 실적 감소 추세를 지속하고 있는 바, 2018년 2,534억 원(-19.7% YoY), 2019년 2,486억 원(-1.9% YoY), 2020년 2,239억 원(-9.9% YoY)의 매출을 기록하였다. 이에 따른 원가 부담의 확대로 수익성 또한 저하되고 있는 가운데, 2020년에는 매출액영업이익률 -2.2%, 매출액순이익률 -7.4%를 기록하면서 수익성이 적자 전환하여 미흡한 수익구조를 나타내었다.

■ 2021년 1분기 부진한 실적 지속 및 손실 발생

2021년 1분기 매출은 549억 원(-19.9% YoY)으로 여전히 부진한 실적을 기록한 가운데, 외형 축소에 따른 고정비 부담 확대와 원가율 상승으로 매출액영업이익률 -6.0%, 매출액순이익률 -3.1%를 기록하여 전년 동기 대비 적자 전환하였다.

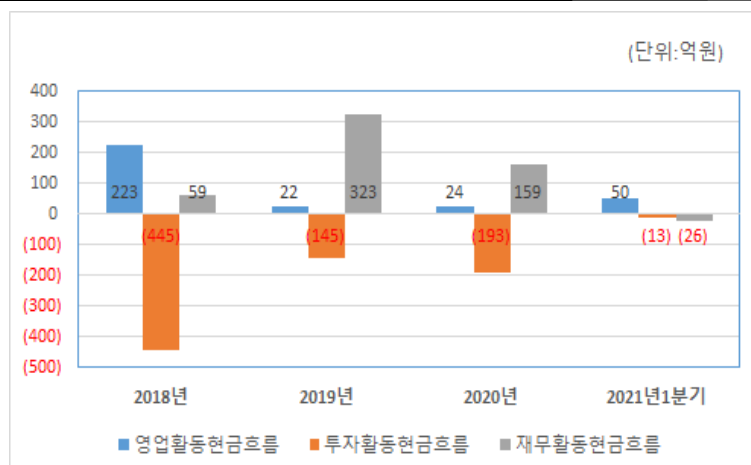
안테나 부품의 계절성, 신제품 관련 비용 집행 및 매출액 감소에 따른 높아진 고정비 비중 등의 영향으로 실적 및 수익성의 단기간 회복은 어려울 것으로 보이나 추후 신제품 출시 효과와 전장 부품 매출 정상화 등을 통해 이익구조 개선이 필요할 것으로 보인다.

한편, 일부 부채 규모 축소로 2021년 1분기 말 자기자본비율 43.0%, 부채비율 132.6%를 기록하여 2020년 12월 말 대비 안정성 지표가 소폭 개선되었으나, 제품 개발을 위한 투자 등으로 차입금의존도는 41.7%를 기록하여 재무 부담은 여전히 높은 편이다.

■ 흑자 상태의 영업활동현금흐름은 유지하나 자금흐름 둔화

2020년은 당기순손실 발생에도 불구하고, 감가상각비 등 현금 유출이 없는 비용의 가산 조정과 매입채무 증가 등의 영향으로 영업활동현금흐름이 흑자 상태를 유지하였으나, 창출된 현금 이 24억 원으로 규모가 과소한 편이다. 반면, 사용권자산 취득 등 투자활동에 소요되는 자금은 약 193억 원으로 영업창출현금을 상회하였고, 부족한 자금은 보유 현금성 자산 및 차입금 등을 통해 충당하여 기말 현금이 감소하였다. 또한, 재고자산과 매출채권 등이 증가함에 따라 전체적으로 자금흐름이 둔화되고 있는 추세이다.

그림 8. 동사 현금흐름의 변화



*출처: 동사 사업보고서(2020), 분기보고서(2021)

V. 주요 변동사항 및 향후 전망

신성장 동력 사업 추진 본격화

전자산업의 쌀로 불리는 MLCC 개발에 성공하며, 양산을 위한 준비과정에 있다. 국내외 주요 통신장비 업체들을 대상으로 영업활동을 진행하고 있으며, 향후 자동차 시장으로 사업을 넓혀갈 계획이다.

■ MLCC 사업 진행 본격화

동사는 적층세라믹콘덴서(MLCC) 개발에 성공하며 양산을 위한 준비과정에 있다. 이는 스마트폰, 전기차, 통신장비 등 들어가지 않은 곳이 없을 정도로 다방면에 사용되고 있어 전자산업의 쌀로 불리고 있다.

동사가 개발한 제품은 칩 사이즈를 유지하면서 안정성을 극대화한 것으로 차세대 MLCC 시장에서 경쟁력을 확보할 것으로 기대하고 있다. 동사가 개발한 MLCC의 경우 정격 전압이 기존 제품보다 10V가량 높아진 16V로 정격 전압이 크게 높아지면서 제품 수명을 40배로 증가시켰다. 또한, 고온 환경에서도 무리 없이 기능을 수행할 수 있는 X7R(X는 최저온도 -55℃, R은 온도의 오차범위 15%, 7은 125℃를 의미) 레벨을 만족하고 있다. 국내외 완성품 업체의 신뢰성 평가를 완료한 상태로 국내외 주요 통신장비 업체들을 대상으로 영업활동을 진행하고 있으며, 향후 자동차 시장으로 영역을 넓혀 다양한 고객사에 납품할 계획에 있다.

■ 관계사인 아모센스의 코스닥 상장

동사는 관계회사인 아모그린텍이 2019년 3월에 코스닥 상장한 데 이어 2021년 6월 아모센스가 상장하였다. 아모센스는 무선 충전기 차폐시트, 전자부품 센서 등을 생산하는 차세대 전장, IoT 솔루션 기업이다. 현재 실적과 관련하여 수익성 악화 지적이 나오고 있으나, 기술 경쟁력을 높여 실적을 회복시키기 위한 전략을 마련하고 있다. 특히 전장 사업 확장을 위한 R&D 투자를 꾸준히 실시하고 있다. 세계 최초로 무선충전 차폐시트를 개발하여 글로벌 시장에서 기술력을 인정받았으며, 향후 IoT 기기와 각종 전장 모듈 부품 사업을 영위하기 위한 기술 확보 작업을 진행할 예정이다.

■ 품질, 환경방침을 기반으로 급변하는 시장 환경에 대응 필요

2021년 1월 14일 금융위원회는 오는 2025년부터 자산 총액 2조 원 이상의 유가증권시장 상장사의 ESG 공시 의무화가 도입되며, 2030년부터는 모든 코스피 상장사로 확대될 것을 발표하였다. ESG 이슈가 대두됨에 따라 주요 기업들도 이에 맞춰 움직이고 있다. 국내 최대 MLCC 선두업체인 삼성전기는 ESG 및 지속가능경영을 위한 조직을 신설하여 중장기적인 개선 목표를 로드맵으로 수립하겠다는 방침이다. 동사는 IT 부문은 물론 미래 유망산업인 에너지, 환경 부문의 핵심 소재 부품 및 솔루션 기술을 위해 연구개발하고 있다.

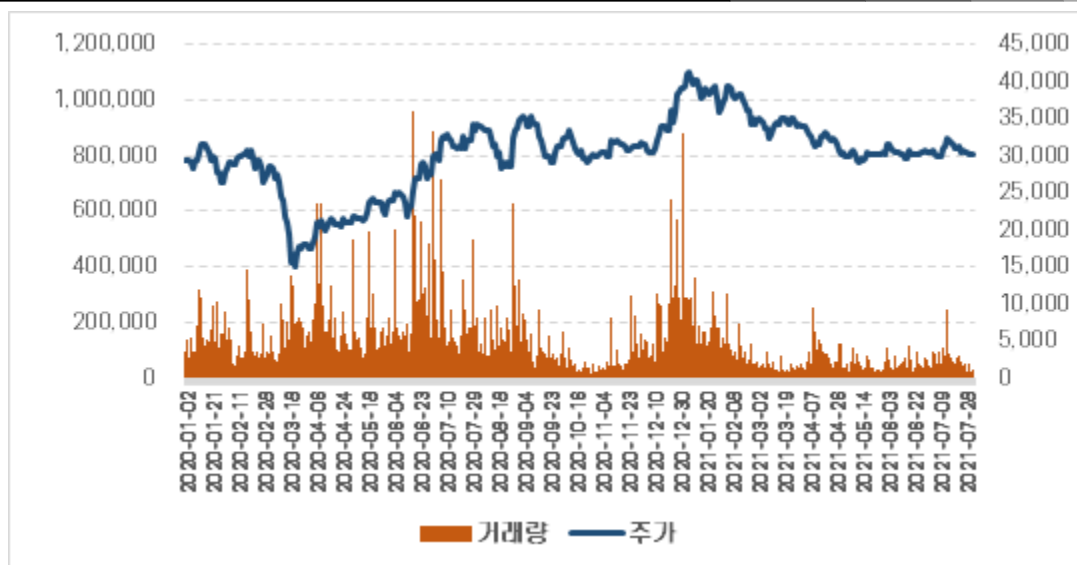


품질, 환경방침을 기반으로 급변하는 시장 환경에 대응하고자 품질경영시스템(ISO 9001), 환경경영시스템(ISO 14001) 등 국제 규격에 의한 품질환경경영시스템을 수립 및 유지하면서 지속적인 품질 및 환경개선을 추진하고 있다. 향후 정부의 정책 변화와 핵심 선도사업 등에 관심을 두고 적극적으로 참여할 필요가 있으며, 경쟁력 강화를 위한 동사만의 비교우위와 차별요소를 탐색하고, 이를 바탕으로 한 연구개발 투자 확대가 요구된다.

■ 증권사 투자의견

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
IBK 투자증권	BUY	45,000	2021-07-12
	<ul style="list-style-type: none"> 3분기부터는 영업 흑자 전환이 가능할 것으로 기대 국내 고객의 신제품 출시 효과와 전장 부품 매출 정상화에 따른 것으로 분석 		
하이 투자증권	BUY	46,000	2021-06-02
	<ul style="list-style-type: none"> 국내 대형 N/W 업체로부터 양산첼 받고 PO를 기다리고 있는 중인 것으로 파악 UWB 솔루션에 대한 완성차 업체의 관심이 커짐에 따라 올해를 기점으로 본격적인 매출 확대 전망 		
현대차 투자증권	BUY	41,000	2021-03-26
	<ul style="list-style-type: none"> 하반기는 MLCC 사업의 실적이 반영되며 상저하의 흐름을 보일 것을 전망 동사의 새로운 성장동력이 하반기부터 반영될 것으로 전망되어 투자의견 BUY와 목표주가 41,000원 유지 		

■ 시장정보(주가 및 거래량)



*출처: Kisvalue(2021.08.)